

证券代码：688135

证券简称：利扬芯片

公告编号：2024-020

广东利扬芯片测试股份有限公司

关于全资子公司拟签订建筑施工合同的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

重要内容提示：

- **合同类型：**采购合同（以下简称“合同”或“本合同”）
- **合同金额：**人民币 5.5 亿元（暂估价格，最终以工程实际价格确定）。
- **合同期限：**开工日期至竣工日期的总日历天数暂定为 563 天（实际以竣工时间为准）。
- **对上市公司业绩的影响：**上海市作为长三角主要城市之一，具有良好的产业优势和地理优势，结合现阶段经营情况和未来业务发展需要，在竞得土地使用权后投资建设集成电路测试项目。本次拟签订的合同是基于上海利扬业务发展需要，在已竞得土地上建筑施工，该合同的履行不会对公司业务、经营的独立性产生影响，公司主要业务不会因履行该合同而对当事人形成依赖，不存在损害公司及全体股东利益的情形。

一、审议程序

广东利扬芯片测试股份有限公司（以下简称“公司”）全资子公司上海利扬创芯片测试有限公司（以下简称“上海利扬”）拟与泉发建设股份有限公司（以下简称“泉发建设”）签订建筑施工合同，本次交易经第三届董事会第二十九次会议审议通过，根据《上海证券交易所科创板股票上市规则》《广东利扬芯片测试股份有限公司章程》等相关规定，无需提交公司股东大会审议。

二、合同标的和相对方当事人情况

（一）合同标的情况

合同标的系在上海竞得土地上施工建设，建设内容包括但不限于：按施工图纸所涉全部土建工程；其他与本次施工建设相配套的工程项目。合同金额为人民币 5.5 亿元（暂估价格，最终以工程实际价格确定）。

（二）合同对方当事人情况

公司名称：泉发建设股份有限公司

统一社会信用代码：913505817490924021

注册资金：30,189 万元人民币

法定代表人：庄清泉

公司地址：福建省泉州台商投资区东园镇东园村溪尾 670 号泉发建设集团总部 1 号楼 10-12 层

成立日期：2003-5-28

经营范围：许可项目：建设工程施工；住宅室内装饰装修；建设工程设计；文物保护工程施工；建设工程监理（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准）；一般项目：园林绿化工程施工；土石方工程施工；体育场地设施工程施工；工程管理服务；物业管理；工程造价咨询业务；建筑材料销售；特种作业人员安全技术培训；业务培训（不含教育培训、职业技能培训等需取得许可的培训）。（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）。

实际控制人：庄清泉（持有泉发建设 70% 股权）

最近一个会计年度（2023 年度）的主要财务数据：由于合同对方当事人为非上市公司，无法提供最近一个会计年度经审计的主要财务数据。

（三）关联关系及业务往来情况说明

公司及控股子公司与泉发建设之间不存在关联关系，本合同的签订不涉及关联交易。

公司及控股子公司最近三个会计年度（2021 年度-2023 年度）与泉发建设发生的业务往来金额分别为人民币 0 万元、2,339.76 万元、13,101.88 万元；分别占公司当年采购总额的 0%、4.86%、22.13%。

三、合同主要条款

（一）发包人：上海利扬创芯片测试有限公司

（二）承包人：泉发建设股份有限公司

（一）合同金额：人民币 5.5 亿元（暂估价格，最终以工程实际价格确定）；

（二）支付方式及支付进度安排：按照项目进度分阶段支付款项；

(三) 履约地点和方式：上海市嘉定区嘉定工业区

(四) 履约期限：开工日期至竣工日期的总日历天数暂定为 563 天（实际以竣工时间为准）；

(五) 合同生效条件和时间：自双方签字并盖章后生效；

(六) 合同签署地点和时间：合同尚未签署；

(七) 主要违约责任：合同双方就逾期完工、未按质按量完成、逾期付款、违反保密条款及知识产权相关条款等情形分别约定了各自应承担的违约责任；

(八) 争议解决方式：合同履行过程中产生争议的，协商解决。协商不成，向工程所在地有管辖权的人民法院提起诉讼。

四、本次签署合同对公司的影响

上海市作为长三角主要城市之一，具有良好的产业优势和地理优势，结合现阶段经营情况和未来业务发展需要，在竞得土地使用权后投资建设集成电路测试项目。本次拟签订的合同是基于上海利扬业务发展需要，在已竞得土地上建筑施工，该合同的履行不会对公司业务、经营的独立性产生影响，公司主要业务不会因履行该合同而对当事人形成依赖，不存在损害公司及全体股东利益的情形。

五、风险提示

合同双方均具有良好的履约能力，但由于合同的执行存在一定周期，在实际履行过程中如遇到不可预计的或不可抗力等因素的影响，可能存在导致合同无法如期或全部履行等风险。敬请广大投资者注意投资风险。

特此公告。

广东利扬芯片测试股份有限公司董事会

2024 年 4 月 10 日